



地址：302082 新竹縣竹北市台元一街1號8樓之2

聯絡人：蔡馨儂

電話：(03)5601777 分機 508

電子信箱：itsai@semi.org

100217 臺北市中正區中山南路五號

受文者：教育部

發文日期：中華民國115年10月6日

發文字號：國際產協字第1151006001號

速別：普通件

附件：附件一、「Chip the Future Challenge」全球學生競賽英文文宣（共2頁）

主旨：敬請貴部協助轉知「Chip the Future Challenge」全球學生競賽資訊予國內各公私立大專院校，鼓勵教師推薦學生組隊參與，拓展半導體人才之國際交流與產業連結，請惠予協助辦理。

說明：

- 一、 SEMI 持續串聯全球半導體產業與學研資源，推動人才培育，透過 SEMI Foundation 辦理之「Chip the Future Challenge」全球學生競賽，提供學生展示研究成果、專題及創新構想之國際平台，並藉由產業專家回饋，促進研究與實際應用之連結。
- 二、 本競賽設有大學部「Innovation Challenge」及研究所「Research Challenge」兩組，學生可依學習階段組隊參與。第一階段僅須提交 400 字英文摘要，無須提交完整提案；入選團隊後續亦有機會獲得 SEMI 會員企業業界導師指導。參賽者保有作品之智慧財產權，相關規範請參閱競賽官網。
- 三、 報名及摘要提交截止日期為 115 年 10 月 31 日。敬請貴部協助轉知國內各公私立大專院校及相關系所，鼓勵教師推薦具潛力之學生或團隊參與，並協助推廣競賽資訊，促進學生與全球同儕交流、接觸國際產業及展現學習與研究成果。
- 四、 競賽英文文宣詳附件一，主辦單位簡介詳附件二；完整參賽資格、競賽時程、提交要求及報名方式，請參閱競賽官網：<https://semifoundation.org/chip-the-future-challenge/>
- 五、 本案聯絡人：蔡馨儂 Ily Tsai，電話 03-5601777 分機 508，電子



信箱：itsai@semi.org。

正本：教育部

副本：國立中山大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立東華大學、國立虎尾科技大學、國立屏東大學、國立屏東科技大學、國立政治大學、國立高雄大學、國立高雄科技大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、國立臺北科技大學、國立臺北教育大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、國立聯合大學、大同大學、中華大學學校財團法人中華大學、中原大學、元智大學、亞洲大學、明志科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、東海大學、長庚大學、修平學校財團法人修平科技大學、高雄醫學大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、逢甲大學、銘傳大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學



CHIP THE FUTURE CHALLENGE™

Designing the Next Generation of Semiconductor Innovation

Have an idea that could shape the future of semiconductors?

The **Chip the Future Challenge™**, a global student competition from the SEMI Foundation, invites university students to tackle real-world semiconductor challenges through research, engineering, and innovation.

Explore what's possible. Develop your idea. Present it to semiconductor industry leaders.

Compete for up to
\$5,000 USD

Open to university students worldwide

Scan to Learn More +
Enter the Challenge



YOUR IDEA COULD HELP SHAPE WHAT'S NEXT.

Compete individually or in a team of up to five students and choose one of two tracks:



RESEARCH CHALLENGE

Advance semiconductor science, engineering, manufacturing, or real-world applications through original research.



INNOVATION CHALLENGE

Develop an original semiconductor solution that addresses an industry challenge or creates measurable value.

Projects can explore areas including **chip design, semiconductor manufacturing, AI hardware, advanced packaging, emerging applications, and more.**

CASH AWARDS

1st Place \$5,000

2nd Place \$3,000

3rd Place \$2,000



Ready to Chip the Future?

Scan the QR code for competition details, eligibility, deadlines, and submission requirements.

主辦單位簡介

SEMI®為全球半導體與電子設計及製造供應鏈產業協會，串聯超過4,000家會員公司與150萬名專業人士。透過政策倡議、人才培育、永續發展、供應鏈管理等多元計畫，促進會員攜手解決產業關鍵挑戰。SEMI所主辦的SEMICON® Taiwan展會與活動、技術社群、標準制定與市場情報，協助會員在設計、元件、設備、材料、服務與軟體等領域推動業務成長與創新，實現更智慧、快速、安全的電子科技。

SEMI Foundation 簡介

SEMI Foundation 成立於2001年，為非營利基金會，致力於拓展人才就業與職涯發展機會，支持微電子產業持續成長。成立初期以全球高中生的科學、科技、工程與數學體驗式教育為主，近年進一步依據產業需求，推動多項人才培育與發展計畫，協助人才建立進入半導體產業的途徑，並支持企業吸引、培育及留任具備多元背景與專業技能的人才。

為深化校園與產業的連結，SEMI Foundation 推動「Chip the Future Challenge」全球學生競賽，邀請大學部及研究所學生以研究成果、專題或創新構想回應半導體產業挑戰，透過國際競賽、產業專家回饋及導師指導機會，促進學習成果與實際應用之銜接，培育新一代半導體人才。